

財團法人台灣建築中心 函

地址：231新北市新店區民權路95號3樓
承辦人：楊明叡
電話：02-8667-6111#210
傳真：02-8667-6222
電子信箱：wool57632@tabc.org.tw

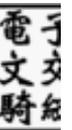
受文者：臺中市政府教育局

發文日期：中華民國113年6月19日
發文字號：中建學字第1139060093號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會-議程 (9060093A00_ATTCH3.pdf、
9060093A00_ATTCH4.jpg)

主旨：內政部建築研究所訂於本（113）年7月5日（星期五）下午14時00分至17時00分舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會-中部場」，敬邀部會機關暨所屬各級建築開發及管理單位、公協會團體、建築開發單位、科技廠辦開發及資產部門、永續財務規劃單位等專責人員踴躍參加及園區管理局協助函請轉知企業本淨零建築活動訊息，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依內政部建築研究所113年3月7日建研秘字第1137648217號函核定「建築物淨零轉型評估推廣計畫」辦理。
- 二、內政部建築研究所依據淨零建築推動策略，建立建築能效分級評估制度，將建築能效依節能成效分為7個等級，其中最高等級為近零碳建築（第1+級），可達約50%的節能，並自111年1月1日實施。為達成前揭2050淨零建築目標，「我



國推動淨零建築與應用推廣計畫」分年分階段辦理淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會，擴大各界公私協力共同推動淨零建築之發展。

三、【淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會】基於2050淨零排放路徑和永續發展，內政部以推動國營企業及民間事業單位之新建及既有建築之淨零發展，擴大跨機構辦理淨零建築政策之推廣效益，以期傳遞淨零建築法制化進程與管制機制，協助企業接軌IFRS國際永續會計準則之揭露內容，並鼓勵公有和民間機關以淨零建築展開多元綠色財務配套，落實淨零建築技術深化達成公正轉型之共榮發展。

四、國家發展委會 113 年 5 月 7 日已修正中央政府機關辦公廳舍建置審核原則，基於「整建優先」及「新建嚴審」，強化整建之辦公廳舍應配合淨零轉型政策並敘明建築物能效情形，本說明會提供相對應諮詢機制歡迎現場索取。

五、邀請對象：「國營事業單位、各級學校、醫療院所及交通場站單位」、「科學園區、產業園區及工業區」、「建築相關專業公協會」、「社會住宅管理單位」、「中央及地方縣市部會機關建設興辦單位及既有建築物業管改善單位」、「淨零建築專責人員」、「企業資產開發人員」、「風險控制人員」、「綠色金融放貸或債券規劃」、「永續財務規劃人員」。

六、本次說明會內容如下：

(一)主題：淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會

(二)日期：113年7月5日（星期五）

(三)時間：14:00-17:00（13:30報到）

(四)地點：集思台中新烏日會議中心3樓瓦特廳（台中市烏日區高鐵東一路26號）

(五)主辦單位：內政部建築研究所

(六)執行單位：財團法人台灣建築中心

(七)協辦單位：國家住宅及都市更新中心、經濟部中臺灣創新園區、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、社團法人台北市會計師公會

(八)報名網址：<https://forms.office.com/r/nLV14EtAQm>

(九)本活動提供公務人員終身學習認證時數、內政部國土管理署建築師開業證書換發積分、行政院公共工程委員會技師執業執照換發積分，請先行線上報名，俾利辦理活動人數統計及後續登錄認證時數等事宜。

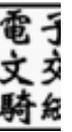
(十)活動議程：

- 1、綠建築發展與淨零建築轉型策略（主講：內政部建築研究所）
- 2、公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益（主講：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）
- 3、既有民間辦公類大樓建築能效實踐分享（主講：國泰人壽保險股份有限公司）
- 4、近零耗能建築技術導入興建社會住宅之淨零手法（主講：國家住宅及都市更新中心）
- 5、國際採用淨零建築標示接軌IFRS會計永續準則的時程及內容說明（主講：台北市會計師公會）
- 6、公有既有建築物淨零建築能效實踐與分享（主講：經濟部中臺灣創新園區）

電子文
騎

8

8、公有民有既有建築物之建築能效申請認定範疇及線上快速自檢平台介紹說明（主講：財團法人台灣建築中心）



正本：外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、交通部、衛生福利部、文化部、勞動部、數位發展部、農業部、環境部、法務部、內政部土地重劃工程處、內政部國土測繪中心、內政部空中勤務總隊、中央警察大學、內政部國家公園署、內政部國土管理署、內政部移民署、內政部消防署、內政部警政署、新竹市政府、新竹市政府工務處、新竹市政府都市發展處、新竹縣政府、新竹縣政府工務處、新竹縣政府產業發展處、苗栗縣政府、苗栗縣政府工商發展處、臺中市政府、臺中市政府都市發展局、臺中市政府建設局、臺中市政府住宅發展工程處、彰化縣政府、彰化縣政府建設處、彰化縣政府城市暨觀光發展處、南投縣政府、南投縣政府工務處、南投縣政府建設處、中央研究院、核能安全委員會、國家發展委員會、中央印製廠、台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、漢翔航空工業股份有限公司、臺鹽實業股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、財團法人工業技術研究院、臺灣菸酒股份有限公司、財政部印刷廠、關貿網路股份有限公司、中華郵政股份有限公司、國營臺灣鐵路股份有限公司、臺灣港務股份有限公司、中華航空股份有限公司、陽明海運股份有限公司、中華電信公司長途及行動通信公司臺中營運處、桃園航勤股份有限公司、臺灣航業股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、中央存款保險股份有限公司、臺灣肥料股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司、農業部農業試驗所、衛生福利部中央健康保險署、財團法人國家衛生研究院、財團法人國防安全研究院、國家中山科學研究院、國家海洋研究院、財團法人國家實驗研究院、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、國立臺灣海洋大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立體育大學、國立聯合大學、國立中興大學、國立臺中教育大學、國立勤益科技大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺中科技大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立成功大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、國立高雄餐旅大學、國立屏東科技大學、國立屏東大學、國立澎湖科技大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、國立臺東大學、國立東華大學、新竹市政府教育處、新竹縣政府教育局、苗栗縣政府教育處、臺中市政府教育局、彰化縣政府教育處、南投縣政府教育處、衛生福利部南投醫院、衛生福利部臺中醫院、衛生福利部苗栗醫院、衛生福利部彰化醫院、衛生福利部豐原醫院、臺中榮民總醫院、交通部民用航空局臺中航空站、臺中市公共運輸及捷運工程處、台灣科學園區科學工業同業公會、經濟部產業園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、經濟部中台灣創新園區、經濟部新竹產業園區、經濟部臺中軟體園區、經濟部潭子科技產業園區、經濟部臺中港科技園區、經濟部大里產業園區、經濟部台中產業園區、經濟部彰濱產業園區、經濟部福興(兼埤頭及田中)產業園區、經濟部芳苑(兼社頭織襪)產業園區、經濟部南崗(兼竹山)產業園區、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、中華民國全國建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會、社團法人苗栗縣建築師公會、社團法人臺中市建築師公會、社團法人



彰化縣建築師公會、社團法人南投縣建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、新竹市不動產開發商業同業公會、新竹縣不動產開發商業同業公會、苗栗縣不動產開發商業同業公會、臺中市不動產開發商業同業公會、彰化縣不動產開發商業同業公會、南投縣不動產開發商業同業公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、新竹市室內設計裝修商業同業公會、新竹縣室內設計裝修商業同業公會、台中市室內設計裝修商業同業公會、彰化縣室內設計裝修商業同業公會、南投縣室內裝潢業職業工會、新竹市建築材料商業同業公會、臺中市建築材料商業同業公會、南投縣建築材料業職業工會、中華民國建築經營協會、臺中市建築經營協會、台灣物業管理學會、台灣物業設施管理協會、臺中市物業管理協會、臺灣銀行、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、中國輸出入銀行、臺灣土地銀行、臺灣金融控股股份有限公司、第一金融控股股份有限公司、兆豐金融控股股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南金融控股股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、大魯閣建設股份有限公司、力山工業股份有限公司、鑽全實業股份有限公司、巨庭機械股份有限公司、喬福機械工業股份有限公司、鋁泰工業股份有限公司、伸興工業股份有限公司、程泰機械股份有限公司、喬山健康科技股份有限公司、豐興鋼鐵股份有限公司、上銀科技股份有限公司、橋樁金屬股份有限公司、華邦電子股份有限公司、菱生精密工業股份有限公司、精元電腦股份有限公司、環隆科技股份有限公司、美律實業股份有限公司、立隆電子工業股份有限公司、百容電子股份有限公司、希華晶體科技股份有限公司、櫻花建設股份有限公司、香港商世界健身事業有限公司台灣分公司、大立光電股份有限公司、亞洲光學股份有限公司、同泰電子科技股份有限公司、玉晶光電股份有限公司、國光生物科技股份有限公司、拓凱實業股份有限公司、大銀微系統股份有限公司、台灣精銳科技股份有限公司、華廣生技股份有限公司、佳凌科技股份有限公司、順天建設股份有限公司、鄉林建設事業股份有限公司、上福全球科技股份有限公司、今國光學工業股份有限公司、中揚光電股份有限公司、惠特科技股份有限公司、志強國際企業股份有限公司、華凌光電股份有限公司、建新國際股份有限公司、新天地國際實業股份有限公司、寶成工業股份有限公司、台灣櫻花股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、成霖企業股份有限公司、五鼎生物技術股份有限公司、聯華電子股份有限公司、全友電腦股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、旺宏電子股份有限公司、台灣光罩股份有限公司、台亞半導體股份有限公司、台灣茂矽電子股份有限公司、鍊德科技股份有限公司、矽統科技股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司、虹光精密工業股份有限公司、凌陽科技股份有限公司、國碩科技工業股份有限公司、友達光電股份有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、偉詮電子股份有限公司、太空梭高傳真資訊科技(股)公司、京元電子股份有限公司、聯發科技股份有限公司、義隆電子股份有限公司、敦陽科技股份有限公司、六福開發股份有限公司、台灣農林股份有限公司、晶豪科技股份有限公司、聯陽半導體股份有限公司、嘉晶電子股份有限公司、聯詠科技股份有限公司、智原科技股份有限公司、富華創新股份有限公司、喬鼎資訊股份有限公司、華晶科技股份有限公司、聯傑國際股份有限公司、緯創資通股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、京鼎精密科技股份有限公司、榮創能源科技股份有限公司、創意電子股份有限公司、群創光電股份有限公司、揚明光學股份有限公



裝

訂

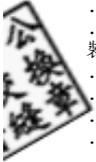
線

司、晶相光電股份有限公司、晶彩科技股份有限公司、州巧科技股份有限公司、敦泰電子股份有限公司、牧德科技股份有限公司、聯合再生能源股份有限公司、通嘉科技股份有限公司、瑞鼎科技股份有限公司、達邁科技股份有限公司、達能科技股份有限公司、富采投資控股股份有限公司、訊映光電股份有限公司、新唐科技股份有限公司、凌通科技股份有限公司、天鈺科技股份有限公司、松翰科技股份有限公司、達運精密工業股份有限公司、宏齊科技股份有限公司、盛群半導體股份有限公司、聯茂電子股份有限公司、聚鼎科技股份有限公司、力成科技股份有限公司、迅杰科技股份有限公司、矽格股份有限公司、達發科技股份有限公司、愛普科技股份有限公司、晶心科技股份有限公司、芯鼎科技股份有限公司、力智電子股份有限公司、力晶積成電子製造股份有限公司、采鈺科技股份有限公司、晉弘科技股份有限公司、天虹科技股份有限公司、矽創電子股份有限公司、昇陽國際半導體股份有限公司、致新科技股份有限公司、鍊寶科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司、微矽電子股份有限公司、富鼎先進電子股份有限公司、年興紡織股份有限公司、冠軍建材股份有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司、超豐電子股份有限公司、兆勁科技股份有限公司、信邦電子股份有限公司、正達國際光電股份有限公司、望隼科技股份有限公司、聯嘉光電股份有限公司、鈺邦科技股份有限公司、澤米科技股份有限公司、凌巨科技股份有限公司、泰山企業股份有限公司、臺灣化學纖維股份有限公司、榮成紙業股份有限公司、順德工業股份有限公司、健和興端子股份有限公司、台灣鋼聯股份有限公司、美利達工業股份有限公司、慶豐富實業股份有限公司、廣隆光電科技股份有限公司、上緯國際投資控股股份有限公司、祺驊股份有限公司、六角國際事業股份有限公司、笙泉科技股份有限公司、弘塑科技股份有限公司、璟德電子工業股份有限公司、波若威科技股份有限公司、亞信電子股份有限公司、優群科技股份有限公司、原相科技股份有限公司、金麗科技股份有限公司、光環科技股份有限公司、鑫創科技股份有限公司、欣銓科技股份有限公司、台星科股份有限公司、點晶科技股份有限公司、宜特科技股份有限公司、上詮光纖通信股份有限公司、熱映光電股份有限公司、漢科系統科技股份有限公司、台灣類比科技股份有限公司、力致科技股份有限公司、聚積科技股份有限公司、力旺電子股份有限公司、世禾科技股份有限公司、逸昌科技股份有限公司、泓格科技股份有限公司、博磊科技股份有限公司、閎康科技股份有限公司、安可光電股份有限公司、光頡科技股份有限公司、光耀科技股份有限公司、碩禾電子材料股份有限公司、漢磊科技股份有限公司、新晶投資控股股份有限公司、聯合光纖通信股份有限公司、前鼎光電股份有限公司、亞洲電材股份有限公司、精拓科技股份有限公司、蒙恬科技股份有限公司、凌網科技股份有限公司、凌陽創新科技股份有限公司、智晶光電股份有限公司、笙科電子股份有限公司、信驊科技股份有限公司、杰力科技股份有限公司、立衛科技股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、鈺創科技股份有限公司、中強光電股份有限公司、均豪精密工業股份有限公司、昇益開發股份有限公司、凱鈺科技股份有限公司、中美矽晶製品股份有限公司、同亨科技股份有限公司、雙喜營造股份有限公司、合邦電子股份有限公司、新普科技股份有限公司、信音企業股份有限公司、茂達電子股份有限公司、振曜科技股份有限公司、頡邦科技股份有限公司、理銘開發股份有限公司、晉泰科技股份有限公司、旺矽科技股份有限公司、泰詠電子股份有限公司、台耀科技股份有限公司、元隆電子股份有限公司、沛亨半導體股份有限公司、大中積體電路股份有限公司、神盾股份有限公司、宇智網通股份有限公司、點序科技股份有限公司、環球晶圓股份有限公司、九齊科技股份有限公司、啟發電子股份有限公司、瑞耘科技股份有限公司、正基科技股份有限公司、宏觀微電子股份有限公司、朋億股份有限公司、鈺太科技股份有限公司、雍智科技股份有限公司、安格科技股份有限公司、廣閣科



技股份有限公司、天擎積體電路股份有限公司、應廣科技股份有限公司、昇佳電子股份有限公司、智聯服務股份有限公司、佑華微電子股份有限公司、榮群電訊股份有限公司、九暘電子股份有限公司、元太科技工業股份有限公司、翔名科技股份有限公司、智捷科技股份有限公司、台灣精星科技股份有限公司、群聯電子股份有限公司、金益鼎企業股份有限公司、米斯特國際企業股份有限公司、振宇五金股份有限公司、海德威電子工業股份有限公司、先進光電科技股份有限公司、利機企業股份有限公司、先益電子工業股份有限公司、映興電子股份有限公司、三一東林科技股份有限公司、新鉅科技股份有限公司、永日化學工業股份有限公司、鏡鈦科技股份有限公司、橙的電子股份有限公司、皇將科技股份有限公司、富宇地產股份有限公司、富宇建設股份有限公司、坤悅開發股份有限公司、鈺鎧科技股份有限公司、光聯科技股份有限公司、德昌營造股份有限公司、聖暉工程科技股份有限公司、久正光電股份有限公司、大城地產股份有限公司、安碁科技股份有限公司、富旺國際開發股份有限公司、高僑自動化科技股份有限公司、韋僑科技股份有限公司、弘煜科技事業股份有限公司、保勝光學股份有限公司、萬年清環境工程股份有限公司、昱展新藥生技股份有限公司、伯特光電股份有限公司、衛司特科技股份有限公司、佑全藥品股份有限公司、長園科技實業股份有限公司、博大科技股份有限公司、愛地雅工業股份有限公司

副本：內政部建築研究所、財團法人台灣建築中心



裝

訂

線

